This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP410010544A

PAT-NO: JP410010544A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10010544 A

TITLE: LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, PHOTOGRAPHIC DEVICE,

AND INFORMATION

PROCESSOR

PUBN-DATE: January 16, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME CHIYOU, KOUYUU TERAMOTO, SATOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

N/A

APPL-NO: JP08185635 APPL-DATE: June 25, 1996

INT-CL_(IPC): G02F001/1339; G02F001/133; G02F001/1345; H01L029/786

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain constitution which is reduced in area in addition to a pixel area and prevent a peripheral driving circuit from being broken with pressure received from a seal material by arranging the seal material on the peripheral driving circuit.

SOLUTION: On the peripheral driving circuit, the seal part 104 is arranged, and this seal part 104 has a function for sealing a space (gap between substrates) 105 so that liquid crystal charged therein will not leak out. Then resin layers 26 and 301 are arranged below the seal material 104, and used in an active matrix area as an inter-layer insulating film and a dielectric for auxiliary capacity while having a function for reducing the pressure that the peripheral driving circuit receives from spacers 103 in the seal material in a

peripheral driving circuit area. Further, the spacers in the seal material 104 prevents locally high pressure from being applied to the peripheral driving circuit so that the peripheral driving circuit is broken.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-10544

(43)公開日 平成10年(1998)1月16日

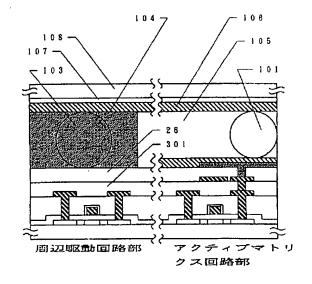
G02F 1/1339 505 1/1339 505 1/1339 505 1/133 505 1/133 505 1/1345 1/1345 H01L 29/786 H01L 29/786 H01L 29/78 612B 審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 8 頁) (21)出願番号 特顧平8-185635 (71)出願人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内 (72)発明者 張 宏男 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内 (72)発明者 守本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内	(51) Int.Cl. ⁶	酸別	記号 庁	'内整理番号	FΙ					技術表示的	あ所
1/1345 H 0 1 L 29/786 H 0 1 L 29/78 6 1 2 B 審査請求 未請求 請求項の数12 F D (全 8 頁) (21)出顧番号 特顧平8-185635 (71)出顧人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 (72)発明者 守本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半	G02F 1	/1339 5 0	5		G02F	1	/1339	505			
田01L 29/786H01L 29/78612B審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 8 頁)(21)出顧番号特顧平8-185635(71)出顧人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内 (72)発明者 守本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内	1	/133 5 0	5			1	/133	505			
審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 8 頁) (21)出願番号 特願平8-185635 (71)出願人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内 (72)発明者 帝本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半	1	/1345				1	/1345				
(21)出願番号 特顧平8-185635 (71)出顧人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 (72)発明者 帝 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半	H01L 29)/786			H01L	H01L 29/78		6121	В		
株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 (72)発明者 守本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半					審査請	求	未請求	請求項の数12	FD	(全 8	頁)
(22)出顧日 平成8年(1996)6月25日 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 株式会社半 等体エネルギー研究所内 (72)発明者 寺本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半	(21)出願番号	特顯平8-1	85635		(71)出顧	人	0001538	78			
(72)発明者 張 宏勇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 (72)発明者 寺本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半							株式会社	上半導体エネルギ	ドー 師	究所	
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内 (72)発明者 寺本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半	(22)出顧日	平成8年(1	996) 6月25	日			神奈川県	厚木市長谷398	番地		
導体エネルギー研究所内 (72)発明者 寺本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半					(72)発明	者	張 宏勇	馬			
(72)発明者 寺本 聡 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半							神奈川場	具厚木市長谷398	番地	株式会社	半
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半							導体エネ	トルギー研究所に	4		
					(72)発明	者	寺本 耳	*			
導体エネルギー研究所内							神奈川リ	県厚木市長谷398	番地	株式会社	半
	•						導体エス	ネルギー研究所に	4		
					1						

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及び撮影装置及び情報処理装置

(57)【要約】

【目的】 周辺駆動回路一体型のアクティブマトリクス 型の液晶表示装置において、画素以外の領域に面積を極 力削減する構成とする。また、そのような構成とした場 合の装置の信頼性を高める。

【構成】 周辺駆動回路上にシール材104を配置する 構成とする。この構成とする場合に、シール材104の 下に樹脂材料でなる層26、301を配置する。このよ うにすることで、シール材104中に含まれるスペーサ -103の影響により、周辺駆動回路に局所的に圧力が 加わることを緩和することができる。そして、周辺駆動 回路が破壊されてしまうことを防ぐことができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】周辺駆動回路一体型のアクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、

周辺駆動回路上にはシール材が配置され、

周辺駆動回路と前記シール材との間には樹脂層が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】請求項1において樹脂層は多層に形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】請求項1において、樹脂層はアクティブマトリクス領域における補助容量の形成に利用されている 10 ことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】請求項1において、樹脂層の厚さはシール 材内のスペーサーの直径の半分以上の厚さを有している ことを特徴とする液晶表示装置。

(請求項5)周辺駆動回路一体型のアクティブマトリクス型の液晶表示装置を具備した撮影装置であって、

周辺駆動回路上にはシール材が配置され、

周辺駆動回路と前記シール材との間には樹脂層が形成されていることを特徴とする撮影装置。

【請求項6】請求項5において樹脂層は多層に形成され 20 ていることを特徴とする撮影装置。

【請求項7】請求項5において、樹脂層はアクティブマトリクス領域における補助容量の形成に利用されていることを特徴とする撮影装置。

【請求項8】請求項5において、樹脂層の厚さはシール 材内のスペーサーの直径の半分以上の厚さを有している ことを特徴とする撮影装置。

【請求項9】周辺駆動回路一体型のアクティブマトリクス型の液晶表示装置を具備した情報処理装置であって周辺駆動回路上にはシール材が配置され、

周辺駆動回路と前記シール材との間には樹脂層が形成されていることを特徴とする情報処理装置。

【請求項10】請求項9において樹脂層は多層に形成されていることを特徴とする情報処理装置。

【請求項11】請求項9において、樹脂層はアクティブマトリクス領域における補助容量の形成に利用されていることを特徴とする情報処理装置。

【請求項12】請求項9において、樹脂層の厚さはシール村内のスペーサーの直径の半分以上の厚さを有していることを特徴とする情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本明細書で開示する発明は、 周辺駆動回路を一体化したアクティブマトリクス型の液 晶表示装置の構成に関する。

【0002】従来より、アクティブマトリクス型の液晶 表示装置が知られている。これは、ガラス基板や石英基 板上にアクティブマトリクス回路と該回路を駆動するための周辺駆動回路とを集積化した構成を有している。

【0003】このような構成においては、画面表示に不 50 ある。このようにすることで、画素における容量を必要

要な部分の面積を極力小さくするための工夫がされている。例えば、周辺駆動回路に占有される面積を極力小さ

る。例えば、周辺駆動回路に占有される面積を極力小さくするような努力がされている。

【0004】一方、液晶表示装置においては、一対の基板間に液晶を保持するために周辺部にシール材と称される液晶を閉じ込めるための封止材料が配置されている。

【0005】上記の画面表示に不要な部分の面積を極力 小さくする工夫の一つとして、上記シール材の占める面 積を削減することも求められている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】周辺駆動回路を一体化 したアクティブマトリクス型の液晶表示装置において は、周辺駆動回路に発生する不良が問題となる。

【0007】特に周辺駆動回路上にシール材を配置し、 画素以外の面積(これを額縁と呼ぶ)を極力小した構成 では、上記周辺駆動回路における不良の発生が多くな る。

【0008】この問題は以下の様な理由で発生する。即ち、シール材中には、基板間隔を維持するためのフィラーと呼ばれる一種のスペーサーが含まれている。

【0009】一般に周辺駆動回路は非常に高い集積度を有している。このような状況においては、上記フィラーの直下に存在することになる周辺駆動回路の薄膜トランジスタや配線にフィラーからの圧力(この圧力は局所的に極めて大きなものと推定される)が加わり、断線やコンタクト不良が発生し易くなる。

【0010】一方、アクティブマトリクス領域においてもスペーサーと呼ばれる球状の基板間隔保持手段が利用されるが、アクティブマトリクス領域は、集積度が低いので、スペーサーの存在による不良の発生は周辺駆動回路ほど問題とならない。

【0011】本明細書で開示する発明は、周辺駆動回路を内蔵したアクティブマトリクス型の液晶表示装置において、画素マトリクス回路の領域以外の面積を極力削減した構成を提供することを課題とする。

【0012】そして上記構成を前提として、シール材から受ける圧力によって周辺駆動回路が破壊されてしまわないような構成を提供することを課題とする。

[0013]

① 【課題を解決するための手段】本明細書で開示する発明の一つは、周辺駆動回路一体型のアクティビマトリクス型の液晶表示装置であって、周辺駆動回路上にはシール材が配置され、周辺駆動回路と前記シール材との間には樹脂層が配置されていることを特徴とする。

【0014】上記構成において、樹脂層は多層に形成されていることが好ましい。これは、シール材中のスペーサーから受ける圧力を緩和させるために効果がある。

【0015】また、樹脂層を利用して、アクティブマトリクス領域における補助容量の形成を行うことは有効で
カスコースのようにオステトで、両妻における容易を必要

Page 2 (HNgo, 09/20/2000, EAST Version: 1.01.0015)

3

とする値でもって得ることができる。

【0016】また、樹脂層の厚さは、シール材内のスペ ーサーの直径の半分以上とすることが好ましい。これ は、樹脂層にシール材内のスペーサーがめり込んでも、 その圧力が周辺駆動回路に及ばないようにするために有 用な条件となる。なお、樹脂層が多層に形成されている 場合には、その合計の厚さをシール材内のスペーサーの 直径の半分以上とすればよい。

【0017】他の発明の構成は、周辺駆動回路一体型の アクティビマトリクス型の液晶表示装置を具備した撮影 10 装置であって、前記周辺駆動回路上にはシール材が配置 され、前記周辺駆動回路と前記シール材との間には樹脂 層が配置されていることを特徴とする。

【0018】上記構成の具体的な例としては、アクティ ビマトリクス型の液晶表示装置を備えた携帯型のビデオ ムービを挙げることができる。

【0019】他の発明の構成は、周辺駆動回路一体型の アクティビマトリクス型の液晶表示装置を具備した情報 処理装置であって、前記周辺駆動回路上にはシール材が 配置され、前記周辺駆動回路と前記シール材との間には 20 樹脂層が配置されていることを特徴とする。

【0020】上記構成の具体的な例としては、アクティ ブマトリクス型の液晶表示を具備した携帯型のパーソナ ルコンピューターや各種情報端末を挙げることができ る。

[0021]

【発明の実施の形態】本明細書で開示する発明の一つの 実施携帯として、図1に示すような、周辺駆動回路一体 型のアクティビマトリクス型の液晶表示装置であって、 動回路と前記シール材との間には樹脂層26及び301 が配置されている構成を挙げることができる。

【0022】上記構成においては、シール材104内に 含まれるスペーサー103によって、周辺駆動回路に局 所的に高い圧力が加わり、周辺駆動回路が破壊されてし まうことを防ぐことができる。

【0023】また、周辺駆動回路上にシール材を配置す ることで、画素領域以外の面積を極力小さくした構成を 実現することができる。

[0024]

【実施例】本実施例に示す構成においては、周辺駆動回 路が存在する領域上にシール材を配置する構成を採用す る。またシール材中に含まれるスペーサーからの応力に よって、周辺駆動回路が損傷することを防止するために 周辺駆動回路上にポリイミドでなる緩衝層を配置する構 成を採用する。

【0025】図1に示されるのは、本実施例のアクティ ブマトリクス型の液晶表示装置の断面の一部である。図 1に示されるのは、周辺駆動回路とアクティブマトリク 動回路一体型と称される構成である。

【0026】図1に示す構成において、周辺駆動回路上 には、104で示されるシール部が配置されている。こ のシール部は105の空間(基板間の隙間)に充填され た液晶が外部に漏れ出ないように封止する機能を有して

【0027】シール部104は、樹脂材料で構成され る。シール部104は、樹脂材料をスピナーによって塗 布し、パターニング、さらにベークすることによって形 成される。または、印刷法によって形成される。

【0028】103で示される基板間隔を保持するため に必要とされスペーサーである。このスペーサーは樹脂 材料でなり、円柱形状を有している。本実施例において は、シール材104を構成する樹脂材料として、スペー サー103が予め混入されているものを利用する。

【0029】シール材104の下部には、樹脂層26と 301が配置されている。この樹脂層は、アクティブマ トリクス領域においては層間絶縁膜、及び補助容量の誘 電体として利用されている。そしてこの樹脂層は、周辺 駆動回路領域においては、シール材中のスペーサーから 周辺駆動回路が受ける圧力を緩和させる機能を有してい る。

【0030】図1に示す構成の作製工程を以下に示す。 以下に示す作製工程は、周辺駆動回路にNチャネル型と Pチャネル型の薄膜トランジスタを配置し、アクティブ マトリクス回路にPチャネル型の薄膜トランジスタを配 置する構成に関する。

【0031】特にNチャネル型の薄膜トランジスタに は、低濃度不純物領域を配置し、Pチャネル型の薄膜ト 周辺駆動回路上にはシール材104が配置され、周辺駆 30 ランジスタには、ソース/ドレイン領域とチャネル形成 領域との間に高濃度不純物領域を配置した構成とする。 【0032】このような構成とすることにより、周辺駆 動回路においては、Nチャネル型の薄膜トランジスタの 特性劣化を抑制することができる。また、アクティブマ トリクス回路においては、OFF電流値が小さく、また ON電流値のバラツキが小さい構成を得ることができ

> 【0033】図2以下に作製工程を示す。図2におい て、左側が周辺駆動回路に配置されるNチャネル型の薄 40 膜トランジスタ(及びその部分)の作製工程である。ま た右側がアクティブマトリクス領域に配置される薄膜ト ランジスタ(及びその部分)の作製工程である。

【0034】まず、図2(A)に示すようにガラス基板 201上に図示しない下地膜を成膜する。下地膜として は酸化珪素膜を利用する。この下地膜はガラス基板20 1中からの不純物の拡散を防ぎ、またガラス基板の応力 を緩和させる機能を有している。

【0035】次に下地膜上に図示しない非晶質珪素膜を プラズマCVD法で500Åの厚さに成膜する。さらに ス回路とを同一基板上に集積化した構造を有する周辺駆 50 レーザー光の照射を行うことにより、非晶質珪素膜を結 晶化させ、結晶性珪素膜を得る。結晶性珪素膜を得る方 法としては、加熱処理、強光の照射を利用してもよい。 【0036】この結晶性珪素膜をパターニングすること により、202、203で示される薄膜トランジスタの 活性層を形成する。ここで、202は周辺駆動回路に配 置されるNチャネル型の薄膜トランジスタの活性層であ る。203はアクティブマトリクス回路に配置されるP チャネル型の薄膜トランジスタの活性層である。

【0037】図には、2つの薄膜トランジスタしか示さ れていないが、実際の構成においては、数万~数十万 (またはそれ以上)の薄膜トランジスタが集積化させ る。

【0038】活性層を形成したら、ゲイト絶縁膜204 として酸化珪素膜を1000Åの厚さにプラズマCVD 法により成膜する。こうして図2(A)に示す状態を得

【0039】図2(A)に示す状態を得たら、ゲイト電 極(及びゲイト配線)を構成するための図示しないアル ミニウム膜をスパッタ法によって4000人の厚さに成 膜する。このアルミニウム膜中にはスカンジウムを0.1 20 2(E)) 重量%含有させる。

【0040】次に図示しない緻密な膜質を有する陽極酸 化膜を100Åの厚さに成膜する。この陽極酸化は、電 解溶液として3%の酒石酸を含んだエチレングルコール 溶液を用いて行う。なおこの溶液はアンモニア水で中和 したものを用いる。

【0041】この陽極酸化膜は、後に配置されるレジス トマスクの密着性を向上させる機能を有する。なお陽極 酸化膜の代わりに窒化珪素膜を金属膜を利用してもよ アルミニウム膜を形成する方法を利用してもよい。

【0042】次にレジストマスク205と206を利用 してこのアルミニウム膜をパターニングする。この工程 で207と208で示されるゲイト電極の基となるアル ミニウムパターンを形成する。こうして図2(B)に示 す状態を得る。

【0043】図2(B)に示す状態を得たら、アルミニ ウムパターン207と208とを陽極とした陽極酸化を 行う。この工程で211と212とで示される多孔質状 する。陽極酸化物の成長距離は5000Åとする。

【0044】この陽極酸化においては、電解溶液として 3%のシュウ酸を含んだ水溶液を用いる。

【0045】この工程においては、レジストマスク20 5と206が存在するので、陽極酸化は、アルミニウム パターン207と208の側面において選択的に進行す る。これは、レジストマスク205と206が存在する ために、アルミニウムパターン207と208の上面に 電解溶液が接触しないからである。ここで、209と2 うして図2(C)に示す状態を得る。

【0046】次にレジストマスク205と206を除去 する。そして緻密な膜質を有する陽極酸化膜の形成を行 う。この陽極酸化は、電解溶液として3%の酒石酸を含 み、アンモニア水で中和されたエチレングルコール溶液 を用いて行う。

6

【0047】この工程においては、多孔質状の陽極酸化 膜211と212中に電解溶液が侵入する。従って、2 13や214で示されるように緻密な膜質を有する陽極 10 酸化膜が形成される。

【0048】この工程において、ゲイト電極209と2 10が画定する。これらゲイト電極の表面は緻密な膜質 を有する陽極酸化膜213、214によって覆われた状 態となる。またこれらのゲイト電極およびそこから延在 した配線が1層目の配線となる。こうして図2(D)に 示す状態を得る。

【OO49】次にP(リン)イオンの注入を全面に対し て行う。この工程では、ソース及びドレイン領域を形成 するために比較的高濃度にPイオンに注入を行う。(図

【0050】この工程において、215、217、21 8、220の領域にPイオンが注入される。また21 6、219の領域には、Pイオンは注入されない。

【0051】次に多孔質状の陽極酸化物211と212 とを除去する。そして図3(A)に示す状態を得る。そ してこの状態において、再度のPイオンの注入を行う。 この工程においては、図2(E)に示すドーピング条件 よりも低ドーズ量でもってPイオンの注入を行う。

【0052】そして221、222、223、224で い。また、酸化性雰囲気中でのプラズマ酸化により酸化 30 示される領域が低濃度不純物領域として形成される。そ してNチャネル型の薄膜トランジスタのチャネル形成領 域20が画定する。(図3(A))

> 【0053】次にNチャネル型の薄膜トランジスタとす る領域をレジストマスク225で覆う。そしてこの状態 でBイオンの注入を行う。この工程は、21と25で示 される領域をPチャネル型の薄膜トランジスタのソース 及びドレイン領域とする条件で行う。

【0054】この工程において、21と25で示される 領域がソース及びドレイン領域となる。また、22と2 の陽極酸化物(膜と表現とするのは適当でない)を形成 40 4で示される領域が21と25で示される領域よりもP 型としての性質が強い領域として形成される。

> 【0055】これは、21及び25の領域よりも22及 び24の領域に含まれるP元素の濃度が低いからであ

> 【0056】即ち、21及び25の領域においては、P 元素を中和させるためにより多くのB元素が必要とさ れ、その結果として、22及び24の領域の方がより強 いP型を発現する状態となる。

【0057】不純物イオンの注入が終了したら、レジス 10とで示されるパターンが後にゲイト電極となる。こ 50 トマスク225を除去する。そしてレーザー光の照射を 行い、注入された不純物の活性化とイオンの衝撃による 半導体膜の損傷のアニールとを行う。

【0058】次に第1の層間絶縁膜226を成膜する。 ここでは、層間絶縁膜226としてプラズマCVD法で 窒化珪素膜を4000Åの厚さに成膜する。

【0059】そしてコンタクトホールを形成し、2層目 の配線(電極)227、228、229、230を形成 する。こうして、図3(C)に示す状態を得る。

【0060】次に第2の層間絶縁膜301を成膜する。 000Åの厚さに形成する。形成方法はスピンコート法 を利用する。

【0061】次にコンタクトホールを形成し、3層目の 配線(電極)231、233を形成する。また同時にア クティブマトリクス回路に配置される薄膜トランジスタ を遮光するための遮光膜232を形成する。この遮光膜 232は後に形成される層間絶縁膜(樹脂膜)を挟んで 画素電極との間で補助容量を形成する。こうして図3 (D)に示す状態を得る。

【0062】次に図4に示すように、第3の層間絶縁膜 20 26を成膜する。ここでは、第3の層間絶縁膜26とし て、スピンコート法で樹脂層を5000Åの厚さ形成す る。そしてコンタクトホールの形成を行い、ITOでも って画素電極234を形成する。

【0063】本実施例においては、第3の層間絶縁膜 (樹脂層) 301を挟んで存在する遮光膜232と画素 電極とでもって補助容量が形成されている。

【0064】さらにラビング膜235を成膜する。ラビ ング膜は樹脂材料でなり、印刷法により形成する。本実 施例においては、アクティブマトリクス回路の領域のみ 30 にラビング膜を形成する。ラビング膜235を成膜した ら、ラビング処理を行う。

【0065】次に図1に示すように、対向基板108を 用意する。対向基板108上には、対向電極107とラ ビング膜106が形成されている。そして対向基板10 8と図3に示す基板とを貼り合わせ、図1に示す構成を 完成させる。

【0066】〔実施例2〕本明細書に開示する発明は、 周辺駆動回路を一体化したアクティブマトリクス型の液 晶表示装置に利用することができる。

【0067】周辺駆動回路を一体化したアクティブマト リクス型の液晶表示装置においては、周辺駆動回路に高 い集積度が要求されるので、本明細書で開示する発明を 利用することは非常に有用である。

【0068】図5(A)に示すのは、デジタルスチール カメラや電子カメラ、または動画を扱うことができるビ デオムービーと称される撮影装置である。

【0069】この装置は、カメラ部2002に配置され たCCDカメラ(または適当な撮影手段)で撮影した画 た画像を本体2001に配置された液晶表示装置200 3に表示する機能を有している。装置の操作は、操作ボ タン2004によって行われる。

8

【0070】本明細書に開示する発明を利用した場合、 高開口率を有した液晶表示装置を得ることができるの で、高い輝度を得ることができる。

【0071】図5(B)に示すのは、携帯型のパーソナ ルコンピュータ(情報処理装置)である。この装置は、 本体2101に装着された開閉可能なカバー(蓋)21 ここでは、第2の層間絶縁膜301として樹脂層を15 10 02に液晶表示装置2104が備えられ、キーボード2 103から各種情報を入力したり、各種演算操作を行う ことができる。

> 【0072】図5(C)に示すのは、カーナビゲーショ ンシステム (情報処理装置) にフラットパネルディスプ レイを利用した場合の例である。カーナビゲーションシ ステムは、アンテナ部2304と液晶表示装置2302 を備えた本体から構成されている。

【0073】ナビゲーションに必要とされる各種情報の 切り換えは、操作ボタン2303によって行われる。一 般には図示しないリモートコントロール装置によって操 作が行われる。

【0074】図5(D)に示すのは、投射型の画像表示 装置の例である。図において、光源2402から発せら れた光は、液晶表示装置2403によって光学変調さ れ、画像となる。画像は、ミラー2404、2405で 反射されてスクリーン2406に映し出される。

【0075】図5(E)に示すのは、ビデオカメラ(撮 影装置)の本体2501にビューファインダーと呼ばれ る表示装置が備えられた例である。

【0076】ビューファインダーは、大別して液晶表示 装置2502と画像が映し出される接眼部2503とか ら構成されている。

【0077】図5(E)に示すビデオカメラは、操作ボ タン2504によって操作され、テープホルダー250 5に収納された磁気テープに画像が記録される。また図 示しないカメラによって撮影された画像は表示装置25 02に表示される。また表示装置2502には、磁気テ ープに記録された画像が映し出される。

【0078】〔実施例3〕本実施例は、周辺駆動回路一 40 体型の液晶表示装置において、薄膜トランジスタとして ボトムゲイト型のものを利用した場合の例である。

【0079】図6に図1に対応する断面図を示す。本実 施例における図1に示す構成との違いは、薄膜トランジ スタの構造である。他の構成は図1に示すものと同様な ものとなる。

[0080]

【発明の効果】本明細書に開示する発明を利用すること により、周辺駆動回路を内蔵したアクティブマトリクス 型の液晶表示装置において、画素マトリクス回路の領域 像を電子的に保存する機能を有している。そして撮影し「50」以外の面積を極力削減した構成を提供することができ

Pイオンの注入されない領域

9

【0081】即ち、周辺駆動回路上にシール材を配置す
る構成とすることにより、画素領域以外に面積を極力削
減した構成を得ることができる。また、このような構成
とした上でさらにシール材から受ける圧力によって周辺
駆動回路が破壊されてしまうことを防ぐ構成を得ること
ができる。

【図面の簡単な説明】

【符号の説明】

る。

【図1】 発明を利用したアクティブマトリクス型の液晶表示装置の断面を一部を示す図。

【図2】 図1に示す構成を得るための作製工程を示す図。

【図3】 図1に示す構成を得るための作製工程を示す図。

【図4】 図1に示す構成を得るための作製工程を示す図。

【図5】 液晶表示装置を利用した各種装置の例を示す図。

【図6】 発明を利用したアクティブマトリクス型の液晶表示装置の断面を一部を示す図。

• / • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
108	対向ガラス基板
107	対向電極
106	ラビング膜
105	液晶
104	シール材
103	スペーサー
101	スペーサー
201	ガラス基板
202,203	活性層
204	ゲイト絶縁膜(酸化珪素膜)
205,206	レジストマスク
207, 208	アルミニウムパターン
209,210	ゲイト電極パターン
211,212	多孔質状の陽極酸化物
213,214	緻密な膜質を有する陽極酸化
膜	
215	ソース領域(Pイオンの注入

された領域)

216

217ドレイン領域 (Pイオンの注入された領域)218Pイオンの注入された領域219Pイオンの注入されない領域220Pイオンの注入された領域221Pイオンの注入された領域

10

(低濃度不純物領域)

 10 20
 チャネル形成領域

 222
 Pイオンの注入された領域

(低濃度不純物領域)

223 Pイオンの注入された領域

(低濃度不純物領域)

224 Pイオンの注入された領域

(低濃度不純物領域)

225レジストマスク21ソース領域 (Bイオンの注入さ

れた領域)

202 2強いP型を有する領域2 3チャネル形成領域2 4強いP型を有する領域2 5ドレイン領域((Bイオンの注)

層間絶縁膜

ラビング膜

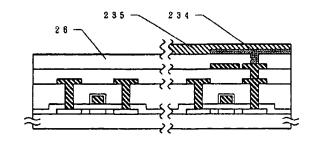
入された領域) 226

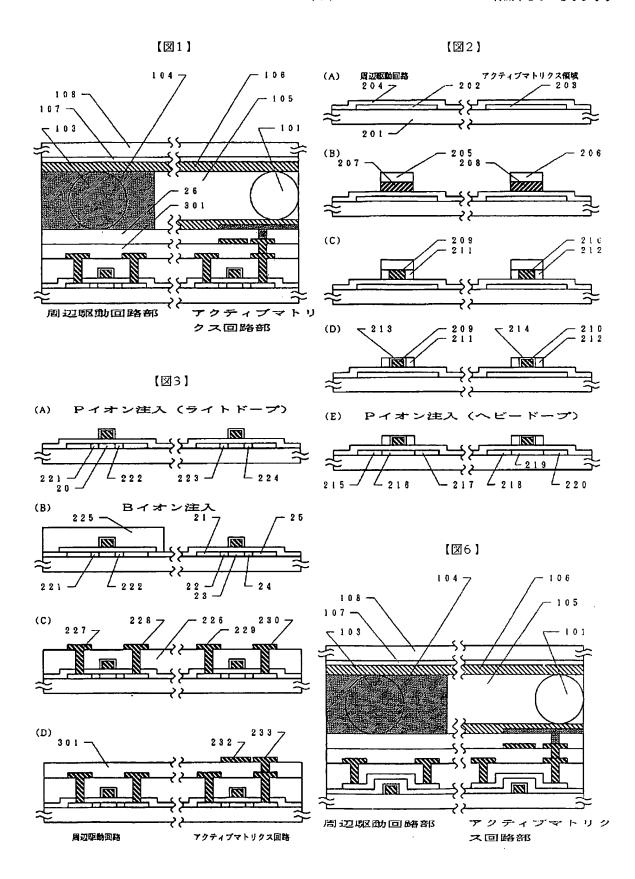
227	ソース電極(ソース配線)
228	ドレイン電極
229	ソース電極(ソース配線)
230	ドレイン電極
301	層間絶縁膜
231	ドレイン電極(ドレイン配
線)	
232	遮光膜
233	ドレイン電極
234	画素電極(ITO電極)
26	層間絶縁膜

【図4】

235

30





Page 7 (HNgo, 09/20/2000, EAST Version: 1.01.0015)

【図5】

